



完成人合作关系说明

1、陈晓宇，第一完成人，主持项目总体方案设计与技术路线制定，组织全流程仿真、模块化并行工艺开发、工艺拉偏优化、量测反馈迭代等核心任务协同推进，牵头关键节点技术评审与质量把关，推动成果在产线转化落地。

2、杜航辉，第二完成人，牵头组建专项攻关团队，攻克工艺参数仿真偏差、批次一致性管控、良率提升等关键难点，通过仿真迭代优化工艺方案，破除新品迭代与良率提升技术瓶颈，推动仿真落地量产。

3、杨小艳，第三完成人，负责芯片的器件结构设计与全流程仿真，开展产品结构全工艺流程模拟推演，提前划定工艺窗口，校核耐压值、导通电阻等关键电性参数，实现结构设计、工艺优化、性能仿真、缺陷预判一体化创新。

4、王文刚，第四完成人，负责模块化并行制造工艺体系建设，缩短产品流片迭代轮次；组织流片前全品类机台能力认证，搭建标准化工艺菜单体系，实现光刻、沉积、刻蚀等关键设备的精准工艺控制。

5、王飞，第五完成人，负责核心工序工艺拉偏试验的设计与实施，围绕热处理温度、光刻曝光尺寸、离子注入深度等关键参数开展系统化拉偏优化，择优锁定最佳匹配工艺方案，保障产品性能达标，支撑器件良率与可靠性提升。

6、张蓓蓓，第六完成人，负责工艺质量管控与快速反馈机制建设，在各关键工艺节点设置备份批次，依托实时量测数据动态微调工艺参数，形成快速反馈与迭代优化闭环，强化批次一致性与过程质量管控。

7、刘禹杉，第七完成人，负责产线工艺工程化与流片验证，协同完成标准化工艺菜单的产线导入与参数固化，组织多轮流片验证与结果分析，支撑仿真优化工艺方案在量产线落地。

第一完成人签名：陈晓宇



完成人合作关系情况汇总表

序号	合作方式	合作者/ 项目排名	合作起始时间	合作完成时间	合作成果	证明材料
1	共同知识产权	陈晓宇/1 王文刚/4 杨小艳/3	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	必备附件 1 其他附件 2
2	共同知识产权	陈晓宇/1 杜航辉/2 王 飞/5	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	必备附件 1 其他附件 2
3	共同知识产权	杜航辉/2 陈晓宇/1 王文刚/4	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	其他附件 2
4	共同知识产权	杜航辉/2 陈晓宇/1 杨小艳/3	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	其他附件 2
5	共同知识产权	杜航辉/2 王 飞/5 刘禹杉/7	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	其他附件 2
6	共同知识产权	杜航辉/2 陈晓宇/1	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	其他附件 2
7	共同知识产权	杜航辉/2 陈晓宇/1 张蓓蓓/6	2023.02	2026.02	集成电路布图设计	其他附件 2

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

第一完成人签名：陈晓宇